

軟電技術在穿戴式 裝置之應用商機

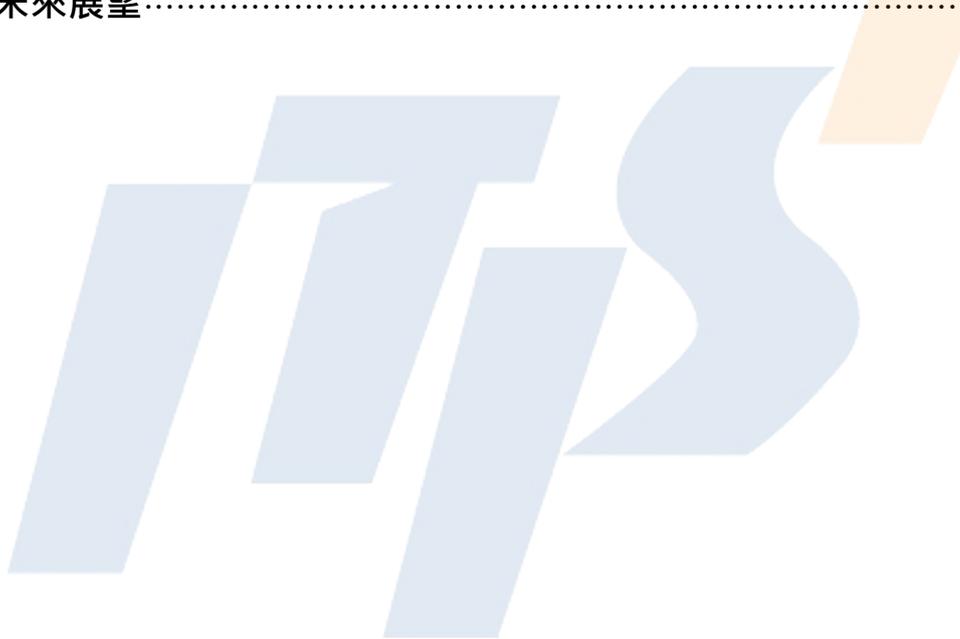
作者：陳仲宜/黃自啟

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇三年七月

目錄

■ 摘要	1
■ 軟性電子發展概述	2
■ 軟電技術範疇及其產品	2
■ 軟電在穿戴裝置的應用	6
■ 未來展望.....	10



軟電技術在穿戴式裝置之應用商機

金屬中心 MII 產業分析師 陳仲宜/黃自啟

摘要：

相較於傳統半導體批次式黃光製程的生產速度緩慢及成本昂貴，建置在塑膠薄片或金屬薄片等軟性基板上的軟性電子技術，其生產製程步驟簡化，且可有以成捲的形式高速連續生產，並不受限於面積大小，因此對降低生產成本更有著極大的改進空間。另一方面，由於其隨著無線通訊的發達與普及，人們對於無所不在資訊的追求愈形強烈，如此一來，具備輕、薄、耐摔，甚至可撓捲等特性的電子產品，更是趨之若鶩。由於軟電技術與各種物件良好的集積性與整合性，已成為穿戴式裝置製造的關鍵技術之一。因此，本文擬探討幾種軟電技術/產品發展概況，及其在穿戴式裝置領域之應用動向。

《軟電技術在穿戴式裝置之 應用商機》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行-和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>